

Issue	封面故事	特別報導	趨勢 & 分析			設計 & 技術	
			業界趨勢	思維與觀點	精英訪談	設計新技術	測試與量測
Jan-Feb 廣告預定截止日期：2025 年 11 月 20 日 材料提交截止日期：2025 年 11 月 30 日	新年展望 / 高層觀點 洞見 AI 新局	EE Award 2025	•	•		AI/HPC/ 雲端 / 邊緣運算	系統級驗證 高速介面 (PCIe /CXL) 測試
						AIoT/ 萬物連網 / 嵌入式設計	
						數位轉型 / 智慧製造 / 綠色永續	
Mar-Apr 廣告預定截止日期：2026 年 2 月 25 日 材料提交截止日期：2026 年 2 月 27 日	EDA，從晶片到系統 / 系統級智慧時代	半導體製程與先進封裝	•	•	•	EDA/IP/ 設計自動化	SoC 功能驗證 / EDA 模擬 / 封測
						系統級 / 模擬與驗證 / 協同設計	
						Chiplet/3D 整合 / 先進封裝	
May-Jun 廣告預定截止日期：2026 年 4 月 20 日 材料提交截止日期：2026 年 4 月 29 日	寬能隙半導體 / 前瞻技術 驅動功率 / 能源新格局	寬能隙半導體 / 前瞻技術	•	•		SiC/GaN/ 功率元件 / 新材料	電源完整性 / 阻抗測試 散熱 / 可靠性測試
						電力轉換 / 馬達控制 /EV 驅動	
						(EV) 電池 /BMS/ 充電樁 / 熱管理	
Jul-Aug 廣告預定截止日期：2026 年 6 月 22 日 材料提交截止日期：2026 年 6 月 30 日	AI 晶片，從雲到端 / 生成式 AI 應用落地	Computex 2026/AI + Tech	•	•	•	Generative AI/AI Agent/Edge AI	網路分析儀 / 訊號完整性測試
						AI 加速器 / 異質架構 /AI 安全	
						記憶體、儲存 / 互連技術	
Sep-Oct 廣告預定截止日期：2026 年 8 月 20 日 材料提交截止日期：2026 年 8 月 31 日	SEMICON / 高功率半導體	SEMICON/ 先進封裝	•	•		無人機 / 機器人 / 自主 / 嵌入式系統	示波器 / 混合訊號測量
						感測器融合 / 機器視覺 / 運動控制	
						電池技術 / 輕量化材料	
Nov-Dec 廣告預定截止日期：2026 年 10 月 20 日 材料提交截止日期：2026 年 10 月 30 日	衛星與下世代通訊 連結無限可能	EE 前瞻技術大會	•	•	•	衛星通訊 /LEO/ 光通訊 / 矽光子	天線設計 /RF 測試 EMI/ 頻譜 / 網路分析儀
						衛星通訊 /LEO/ 光通訊 / 矽光子	
						車聯網 / 智慧車 / 網路安全	

編輯查詢

有關台灣版的編輯及其他相關事項查詢, 請與 Anthea Chuang(anthea.chuang@aspencore.com)聯繫。

備註: 發行人保留對以上文章刪修的權利。

Issue	Cover Story	Special Report	Trend & Analysis			Design & Technology	
			Tech Trends	Opinions	Interview	Design Corner	Test & Measurement
Jan-Feb Ad Booking Deadline: 20-Nov-2025 Ad Materials Deadline: 30-Nov-2025	New Year Outlook / Navigating the New AI Era	EE Award 2025	•	•		AI/HPC/Cloud/Edge Computing	System
						AIoT/Connectivity/Embedded Design	Verification/HS
						DX/Smart Manufacturing/Sustainability	Interface Testing
Mar-Apr Ad Booking Deadline: 25-Feb-2026 Ad Materials Deadline: 27-Feb-2026	EDA / From Chip to System Intelligencee	Semiconductor Process & Advanced Packaging	•	•	•	EDA/IP/Design Automation	SoC Verification
						System-level Co-Design/Verification	EDA Simulation
						Chiplet & 3D/Advanced Packaging	P&T
May-Jun Ad Booking Deadline: 20-Apr-2026 Ad Materials Deadline: 29-Apr-2026	Wide Bandgap & Emerging Technologies — Powering the Next Energy Era	WBG Semiconductors / Advanced Power Technologies	•	•		SiC/GaN Power & Materials	Power/Impedance
						Power Conversion/Motor Control/EV Drive	/Thermal &
						EV Batteries/BMS/Thermal Management	Reliability Test
Jul-Aug Ad Booking Deadline: 22-Jun-2026 Ad Materials Deadline: 30-Jun-2026	AI Chips: From Cloud to Edge — Generative AI in Action	Computex 2026/AI + Tech	•	•	•	Generative AI/AI Agent/Edge AI	Network Analyzers
						AI Accelerators/Heterogeneous/Security	Signal Integrity
						Memory/Storage & Interconnect	Testing
Sep-Oct Ad Booking Deadline: 20-Aug-2026 Ad Materials Deadline: 31-Aug-2026	Low-Altitude Economy & Humanoid Robotics — The Next Chip Revolution	SEMICON / High-Power Semiconductors	•	•		Drones/Robotics/Autonomous Systems	Oscilloscopes
						Sensor Fusion/ML/Motion Control	Mixed-Signal
						Battery Tech/Lightweight Materials	Measurement
Nov-Dec Ad Booking Deadline: 20-Oct-2026 Ad Materials Deadline: 30-Oct-2026	Satellites & Next-Gen Communications — Connecting the Future	EE Intelligent Techcon	•	•	•	Satellite Comm/LEO/Silicon Photonics	Antenna & RF
						B5G/6G/mmWave/RF Front-End	EMI / Spectrum
						IoV/Smart Mobility/Network Security	Network Analysis

Editorial inquiries For EETT magazine issue please contact Anthea Chuang (anthea.chuang@aspencore.com).

Note: The publisher reserves the right to reschedule any topic in the calendar.